



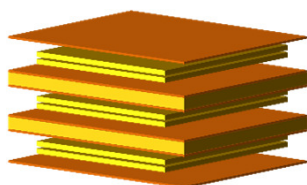
Construction Multicouches

Type de multicouche	Épaisseur Finale	Code	Liste des Matériaux	Notes
 Multicouche 4 couches	0,8 mm (± 0,1 mm)	4080036	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 360 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit
	1,0 mm (± 0,1 mm)	4100051	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 510 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit
	1,2 mm (± 10%)	4120036	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 360 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit
	1,4 mm (± 10%)	4140051	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 510 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit
	1,6 mm (± 10%)	4160071	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 710 µm (± 75µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit
		4160102	Cuivre de Base 17-35 µm 1 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) 1 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 1020 µm (± 75µm) Cuivre de Base 35 µm 1 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm)	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit <i>Construction alternative à utiliser en cas de rupture de stock de matériel standard ou sur demande du client</i>
	1,8 mm (± 10%)	4180102	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 1020 µm (± 10%) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit
	2,0 mm (± 10%)	4200120	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 1200 µm (± 10%) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit
	2,4 mm (± 10%)	4240160	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 1600 µm (± 10%) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit



Construction Multicouches

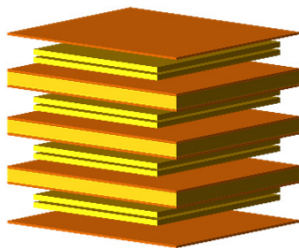
Type de multicouche	Épaisseur Finale	Code	Liste des Matériaux	Notes
Multicouche 4 couches (continuation)	2,8 mm (± 10%)	4280160	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 2000 µm (± 10%) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit
	3,2 mm (± 10%)	4320240	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 2400 µm (± 10%) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes ou internes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit
Multicouche 6 couches	1,2 mm (± 10%)	6120025	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 254 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 254 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit
	1,4 mm (± 10%)	6140036	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 360 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 360 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit
	1,6 mm (± 10%)	6160051	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 510 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 510 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit
	1,8 mm (± 10%)	6180025	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 254 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 254 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit
	2,0 mm (± 10%)	6200071	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 710 µm (± 75µm) Cuivre de Base 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 710 µm (± 75µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit
	2,2 mm (± 10%)	6220051	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 510 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 510 µm (± 50µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit





Construction Multicouches

Type de multicouche	Épaisseur Finale	Code	Liste des Matériaux	Notes
Multicouche 6 couches (continuation)	2,4 mm (± 10%)	6240071	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 710 µm (± 75µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 710 µm (± 75µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit
	2,8 mm (± 10%)	6280102	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 1020 µm (± 10%) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 1020 µm (± 10%) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit
	3,2 mm (± 10%)	6320102	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 1020 µm (± 10%) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 1020 µm (± 10%) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 7628 170 µm (± 20 µm) Cuivre de Base 17-35 µm	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 140 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit
Multicouche 8 couches	1,6 mm (± 10%)	8160025	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 254 µm (± 50 µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 254 µm (± 50 µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 254 µm (± 50 µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 254 µm (± 50 µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm)	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 280 µm à l'épaisseur finale du circuit
	2,4 mm (± 10%)	8240051	Cuivre de Base 17-35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 35 µm Core 510 µm (± 50 µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 510 µm (± 50 µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 510 µm (± 50 µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm) Cuivre de Base 17-35 µm Core 510 µm (± 50 µm) Cuivre de Base 35 µm 2 x Pre-Preg 1080 70 µm (± 10 µm)	1. Cuivre de base externes = 70 µm, ajouter 70 µm à l'épaisseur finale du circuit 2. Cuivre de base internes = 70 µm, ajouter 210 µm à l'épaisseur finale du circuit 3. Cuivre de base externes et internes = 70 µm, ajouter 280 µm à l'épaisseur finale du circuit



NOTES

Ci-dessous vous trouverez les différentes constructions que nous utilisons pour obtenir les épaisseurs les plus utilisées par nos clients.

Toutefois, nous vous invitons à nous consulter au sujet de tous les empilages dont vous avez besoin et qui ne sont pas inclus dans la liste ci-dessous et notre département technique étudiera sa viabilité.